



EV Group präsentiert Hybrid- und Fusion-Bonding-, Layer-Transfer- und maskenlose Lithographie-Technologien für zukunftsweisende Speicherchips und Packaging-Anwendungen auf der SEMICON Korea 2026

ST. FLORIAN am Inn, Österreich, 4. Februar 2026— EV Group (EVG), ein führender Anbieter von innovativen Prozesslösungen und Know-how zur Umsetzung zukunftsweisender Halbleiterdesigns und Ansätzen zur 3D-Integration von Mikrochips, gab heute bekannt, dass sie ihre neuesten Lösungen für heterogene Integration, Advanced Packaging und die Herstellung von Fine-Pitch-Wafer-Probe-Karten auf der SEMICON Korea 2026, die vom 11. bis 13. Februar im COEX Exhibition Center in Seoul stattfindet, vorstellen wird. Zu diesen Lösungen gehören die GEMINI® FB-Wafer-Bonding-Systeme von EVG, das EVG®40 D2W-Die-to-Wafer Overlay Metrology-System, die IR LayerRelease™-Technologieplattform für den Layer-Transfer und das durchsatzstarke maskenlose Belichtungssystem LITHOSCALE® XT.

Die Anlagen und Prozesslösungen von EVG spielen eine entscheidende Rolle bei der Fertigungsoptimierung in verschiedenen Technologiebereichen, darunter High-Bandwidth-Memory (HBM) und andere Advanced Memory-Technologien sowie moderne Packaging- und MEMS-Anwendungen, darunter Sensoren und die Fertigung von Fine-Pitch Wafer-Probekarten. Auf der SEMICON Korea 2026 wird EVG außerdem mit zwei Fachvorträgen zu seinen IR-LayerRelease- und maskenlosen Belichtungsplattformen vertreten sein. Das Unternehmen präsentiert sich am Stand DS26.

„Technologieunternehmen und Forschungsinstitute in Korea spielen weiterhin eine zentrale Rolle bei der Förderung von Innovationen in der globalen Halbleiterindustrie, insbesondere in den Bereichen fortschrittlicher Memory-, 3D-Integrations- und Packaging-Technologien“, erklärte Georg Berger, Regional Sales Manager, Asia/Pacific bei EV Group. „EVG ist stolz darauf, seine Kunden und Partner in Korea mit bewährten Lösungen und starken lokalen Anwendungs- und Servicekompetenzen zu unterstützen.“

Justin Yun, General Manager von EV Group Korea, fügte hinzu: „Veranstaltungen wie die SEMICON Korea bieten uns eine wichtige Gelegenheit, unsere neuesten Entwicklungen in den Bereichen Hybrid Bonding, Lithographie und Schichttransfer zu präsentieren und mit den führenden Unternehmen der Branche zusammenzuarbeiten, die die Zukunft der Halbleiterfertigung maßgeblich mitgestalten.“

Unterstützung von hocheffizientem Hybridbonding für Advanced Memory und 3D-Integration

Wafer-to-Wafer (W2W)-Hybridbonding ist entscheidend für die hocheffiziente, skalierbare Fertigung von 3D-NAND- und DRAM-Speicherchips der nächsten Generation, die eine Ausrichtungsgenauigkeit im Submikrometerbereich und eine hohe Bondstärke erfordern. Die-to-Wafer (D2W)-Hybrid Bonding ist ein wichtiger Faktor für die Integration von Chiplets, HBM-Stacks und 3D-System-on-Chip (SoC)-Integrationsprozessen. EVG bietet einen kompletten Hybrid Bonding-Prozess für W2W-Bonding sowie umfassende Unterstützung für D2W Hybrid Bonding, einschließlich Oberflächenvorbereitung, Reinigung, Collective Die-Transfer und hochpräziser Ausrichtung. Das kürzlich vorgestellte EVG40 D2W System bietet eine hochpräzise Inline-Overlay-Messtechnik für D2W-Bonding und unterstützt Echtzeit-Feedbackschleifen, mit denen Kunden die Genauigkeit und Performance der Die-Platzierung maximieren können.

Maskenlose Lithographie für fortschrittliche Packaging- und Probe-Card-Anwendungen

Die LITHOSCALE-Plattform von EVG kombiniert hochauflösende, nahtlose Strukturierung mit leistungsstarker digitaler Lithographie und hohem Durchsatz und bietet damit eine überzeugende Lithographie-Lösung für eine Vielzahl von Packaging- und MEMS-Anwendungen. Dazu gehören Fan-Out-Wafer-Level-Packaging (FOWLP) für KI- und Hochleistungsrechner (HPC), Fine-Pitch-Wafer-Probekarten,

Bildsensoren der neuesten Generation und die Rückverfolgbarkeit von Chips für Sicherheits- und Automobilanwendungen. Mit ihrer hohen Belichtungsgeschwindigkeit, flexiblen Datenverarbeitung und skalierbaren Architektur eignet sich die MLE™-Technologie (Maskless Exposure) von EVG ideal für Produktionsumgebungen, die hochauflösende Strukturierung und schnelle Designwechsel erfordern. Das neue LITHOSCALE XT System, das im Vergleich zum bisherigen Branchen-Benchmark LITHOSCALE den Durchsatz um das Fünffache steigert, ermöglicht den Einsatz der digitalen Lithographie in der Serienfertigung für heterogene Integrationsanwendungen.

IR LayerRelease ermöglicht dünne Chip-Stacks

Die IR LayerRelease Technologie von EVG ist eine vollständig Front-End-kompatible Layertransfer-Technologie, die mit einem Infrarotlaser (IR) arbeitet, der Silizium durchdringen kann, welches für die Wellenlänge des IR-Lasers transparent ist. In Verbindung mit speziell formulierten anorganischen Schichten ermöglicht diese Technologie die nanometergenaue, lasergesteuerte Ablösung beliebiger ultradünner Filme oder Schichten von Siliziumträgern und bietet den höchsten Durchsatz der Branche. Dadurch macht IR LayerRelease die Notwendigkeit von Glasträgern beim Advanced Packaging überflüssig und ermöglicht völlig neue Prozessabläufe für 3D-IC- und 3D Sequential Integration-Anwendungen – einschließlich Hybrid- und Fusionbonding selbst ultradünner Schichten auf Siliziumträgern.

Fachvorträge auf der SEMICON Korea 2026

EVG nimmt auch in diesem Jahr am SEMI Technology Symposium (STS) der SEMICON Korea teil und präsentiert folgende Vorträge:

- **„High Throughput Digital Lithography Development Enables AI and HPC Device Integration”** (S1 Advanced Lithography Session, Mittwoch, 11. Februar, 15:15–15:40 Uhr, Raum 307) – präsentiert von Dr. Ksenija Varga, Business Development Manager
- **„EVG LayerRelease Technology – Key Innovations in Carrier Systems: Addressing D2W and W2W Stacking Requirements”** (S6 Advanced Packaging Session, Donnerstag, 12. Februar, 17:25–17:50 Uhr, Raum 317) – präsentiert von Dr. Thomas Uhrmann, Vice President of Sales

EVG auf der SEMICON Korea 2026

Besuchen Sie den Stand DS26 von EVG während der Messezeiten, um mit einem EVG-Spezialisten zu sprechen und mehr über die branchenführenden Lösungen des Unternehmens für Hybrid Bonding, maskenlose Lithographie und den Transfer ultradünner Schichten zu erfahren.

Über EV Group (EVG)

EV Group (EVG) bietet innovative Prozesslösungen und Know-how zur Umsetzung zukunftsweisender Halbleiterdesigns und Ansätze zur 3D-Integration von Mikrochips. Der Leitgedanke bzw. die Vision des Unternehmens, erster in neuesten Technologien zu sein und fortschrittlichste Anwendungen der Mikro- und Nanotechnologie zu unterstützen, ermöglicht den Kunden die erfolgreiche Vermarktung ihrer neuen Produktideen. Die für die Hochvolumenproduktion ausgelegten Produkte der EV Group, zu denen Waferbonding-, Lithographie-, Dünnpwafer-Verarbeitungs- und Messtechniksysteme gehören, ermöglichen weitere Fortschritte bei der Skalierung des Halbleiter-Frontends, der 3D-Integration und beim Advanced Packaging sowie bei anderen Elektronik- und Photonikanwendungen. Mehr Informationen unter www.EVGroup.com

Kontakte:

Clemens Schütte
Director, Marketing and Communications
EV Group
Tel: +43 7712 5311 0
E-mail: Marketing@EVGroup.com

David Moreno
Principal
Open Sky Communications
Tel: +1.415.519.3915
E-mail: dmoreno@openskypr.com

###